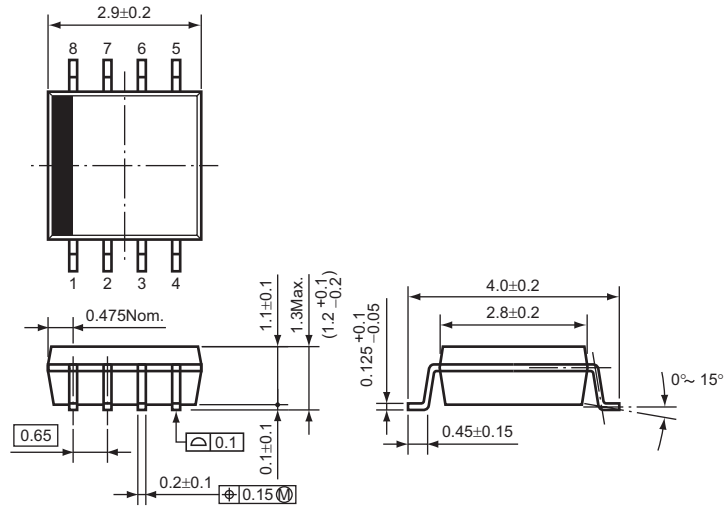


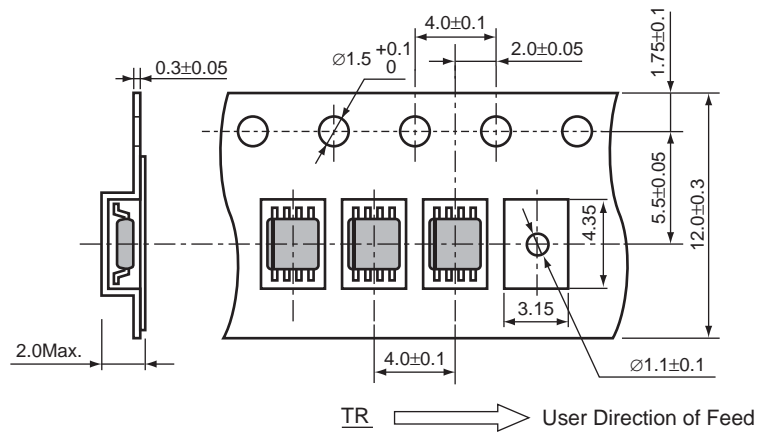
SSOP-8G

(単位 : mm)

■ パッケージ外形図

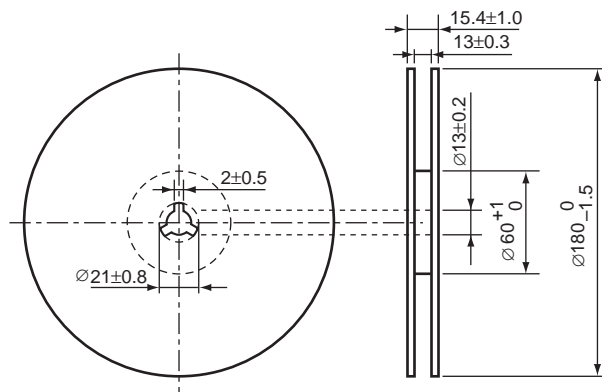


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リユースリール (EIAJ-RRM-12Bc)

(1 リール=3,000 個)



### ■ 許容損失について (SSOP-8G)

SSOP-8Gパッケージの許容損失について特性例を示します。

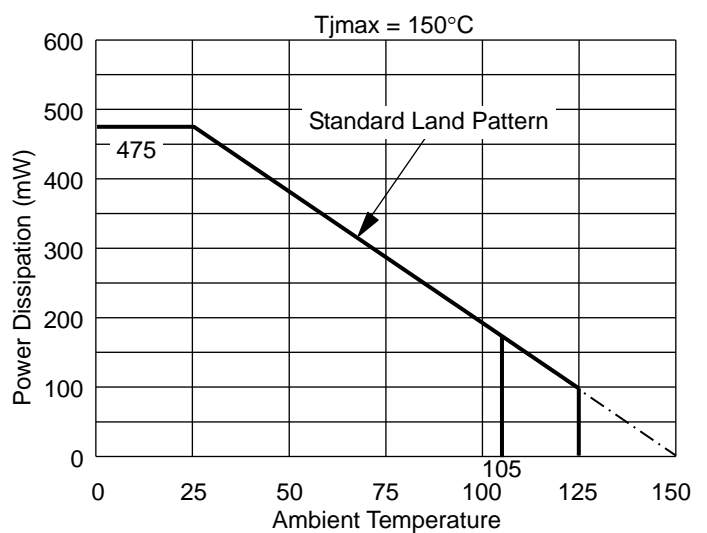
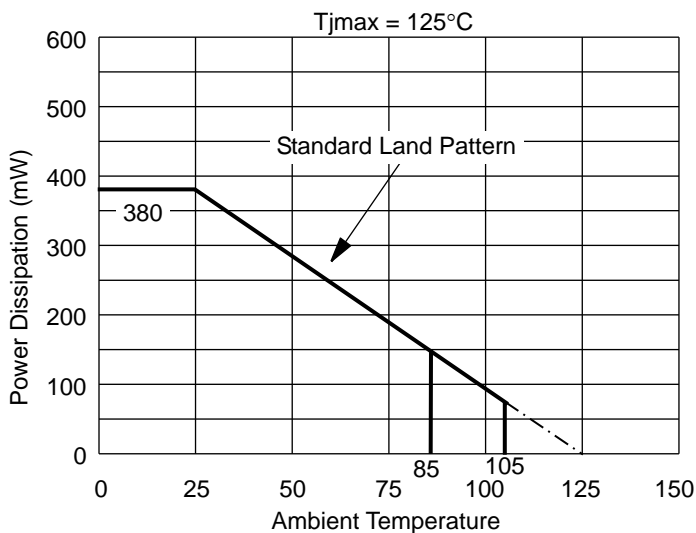
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

標準実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40 mm × 40 mm × 1.6 mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.5 mm × 44 個

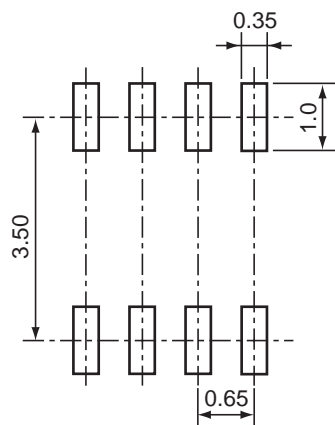
測定結果 (Ta=25 °C)

標準実装条件	
許容損失	380 mW (Tjmax = 125°C) 475 mW (Tjmax = 150°C)
熱抵抗値	$\theta_{ja} = 263^{\circ}\text{C/W}$ $\theta_{jc} = 60^{\circ}\text{C/W}$

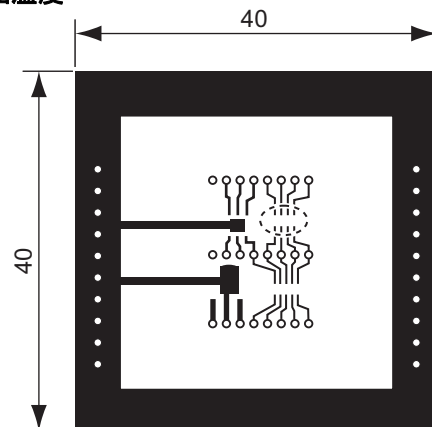


許容損失 対 周囲温度

### ■ 基板パッド推奨寸法 (SSOP-8G)



(単位 : mm)



○ IC 実装位置 (単位 : mm)  
測定用基板レイアウト